

● DFN3030-10Bパッケージ許容損失(JESD51-7)

DFN3030-10Bパッケージにおける許容損失特性例となります。

許容損失は実装条件等に影響を受け値が変化するため、下記実装条件にての参考データとなります。

1.測定条件(参考データ)

測定条件：基板実装状態

雰囲気：自然対流

実装：Pbフリーはんだ

実装基板：銅箔4層基板76.2mm × 114.3mm(片面約8700
mm²)に対して銅箔面積

1層目：銅箔無し

2層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

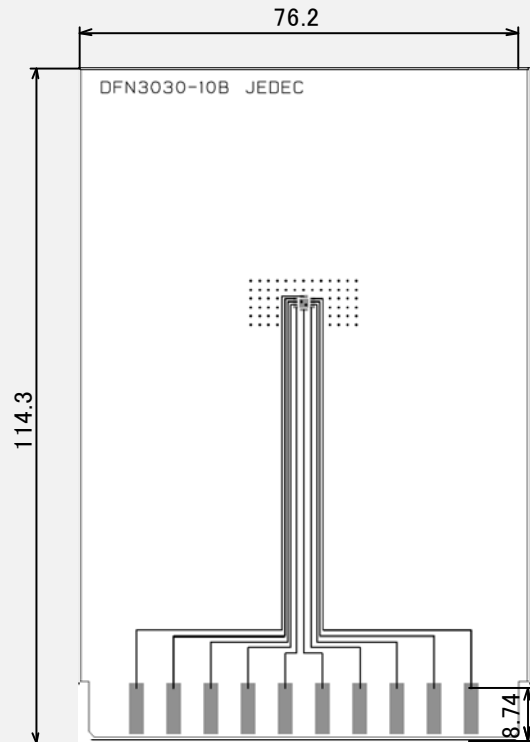
3層目：70mm × 70mm_放熱板と接続有

4層目：銅箔無し

基板材質：ガラスエポキシ(FR-4)

板厚：1.6mm

スルーホール：φ0.2mm 60個



2.許容損失-周囲温度特性

評価基板レイアウト(単位:mm)

基板実装($T_{jmax} = 125^{\circ}C$)

周囲温度(°C)	許容損失Pd(mW)	$\theta_{ja}(^{\circ}C/W)$
25	1950	51.28
105	390	

